



IT-SoC Fair 2006 전시회

모바일용 SoC 집중 부각 ... 국내 비메모리 반도체산업 '전성기'

IT관련 반도체, 특히 SoC 산업의 현주소를 알아보고 발전방향을 모색해보고자 열린 'IT-SoC Fair 2006' 전시회 및 컨퍼런스가 지난 1~2일간 서울 코엑스에서 열렸다. 많은 업체들이 참여한 것은 아니었지만, 나름대로 기술력을 갖춘 업체들이 다수 부스를 꾸려 행사장을 찾은 관람객을 흡족하게 만들었다.

글 | 김종률 기자(모바일타임스)

실리콘웍스(www.siliconworks.co.kr)는 모바일기기 디스플레이용 드라이버IC를 전시했다. 그동안 중대형 패널 드라이버IC에 치중하던 실리콘웍스는 최근 QVGA급 TFT패널 드라이버IC인 'SW1605S'와 VGA급 FPD패널 드라이버IC인 'SW7603'을 개발, 이번 전시회에서 공개했다. 드라이버IC의 3가지 핵심칩을 모두 집적시킨 것이 특징이다.

토마토LSI(www.tomatolsi.com) 역시 휴대폰 디스플레이용 드라이버IC를 전시했다. 현재 이 회사는 QVGA급 TFT패널용 제품을 주력으로 삼고 있으며, 이 제품은 삼성전자 휴대폰에만 채용되고 있다. 이 제품에 이어 토마토LSI는 같은 QVGA급 TFT패널용 'TL1763'을 시장에서 활성화시키고자 노력하는 한편 내년 시장을 기대하며 VGA급 TFT패널용 드

라이버IC도 개발했다.

파이칩스(www.phychips.com)는 RF전문 회사로, GPS, 지그비 등의 분야에서 RF칩을 공급한다. 이번 전시회에서도 이와 관련된 CMOS 방식 RF칩을 공개했다.

넥실리온(www.nexilion.co.kr)은 지상파DMB용 칩을 출시했다. 베이스밴드와 AV기능이 원칩화돼 있다. 이미 KTFT의 휴대폰에 채용돼 상용화를 이뤘으며, 다음달 중으로 LG텔레콤이 출시하는 캔유 휴대폰에도 채용이 결정됐다.

PMP 및 내비게이션 업체로는 햄팩스, 퓨전소프트, 유경, 퍼스텔, 아이나비 등이 넥실리온 칩을 채용하고 있다.

넥실리온은 내년 초 지상파DMB의 3대 핵심 부품인 AV 디코더, 베이스밴드, RF를 모두 집적한 원칩을 출시한다는

방칩이다. 3대 부품을 하나로 집적한다면 업계 최초 사례가 된다.

넥스트칩(www.nextchip.com)은 모바일기기용 입출력 칩을(NVP7000) 개발하는 것으로 모바일 시장에 진출했고, 이번 전시회에서 이 칩을 선보였다. 넥스트칩 제품은 간단히 말해 모바일기기의 입출력 단자 역할을 한다. 휴대폰의 TV아웃 기능 같은 역할인 셈이다.

매직아이(www.emsdigital.com)는 MMSP2의 후속버전으로 업계 기대를 받았던 MMSP2+를 드디어 개발, 이번 전시회에 출품했다.

애초 MMSP3로 기획됐던 이 제품은 그동안 매직아이가 출시했던 제품의 일부 기능을 통합시킨 정도라는 이유로 결국 MMSP2+ 명칭에 그쳤다.

그러나 ARM9 코어 2개를 채용했으며, 성능을 300MHz 및 250MHz로 올렸다. 3D 기능을 지원하는 외 H.264코덱도 사용할 수 있게 했다. 내비게이션과 PMP의 화면분할 기능은 MMSP2부터 실현됐으며, MMSP2+에서도 그대로 이어 받았다.

FCI(www.fci.co.kr)는 지상파DMB용 RF칩(FC2501)을 집중 홍보했다. 국내에 흔치 않는 RF칩 전문 회사로 명성을 갖고 있는 이 회사는 휴대폰용 RF칩도 개발한 바 있다.

FCI의 RF칩은 현재 PNP, 텔레칩스, 센트로닉스 같은 지상파DMB용 베이스밴드 칩 업체에 공급돼 원칩화되기도 했다. 물론 원칩은 베이스밴드칩 업체 브랜드로 출시됐다. FCI는 내년 2월 DVB-H와 지상파DMB용 듀얼RF칩도 출시한다는 방침이다.

신코엠(www.syncoam.com)은 유기EL 드라이버IC 사업을 진행하고 있는 회사. TFT패널용 드라이버IC 제품도 있지만, 이 시장은 경쟁이 치열해 사업을 집중적으로 진행하지 않는다는 게 회사 방침이다.

신코엠의 유기EL 드라이버IC로는 현재 128×160도트를 비롯해 160×128도트, 220×176도트 등의 제품이 있다. 대부분 휴대폰 메인 디스플레이를 구동시킬 수 있다.

픽셀플러스(www.pixelplus.com)는 최근 개발한 200만 화소 AF알고리즘 내장 휴대폰 카메라용 센서를 출시했다. 아직 양산은 진행되지 않고 있다. 회사측은 노이즈를 잡은 후 모듈



업체에 공급할 방침이라고 전했다. 픽셀플러스는 내년 초 3.2메가 지원 센서도 출시할 예정이다.

마무리안디자인(www.mamurian.com)은 모바일기기용 코덱칩 개발 회사.

이 회사가 전시회에 출품한 칩(ViDan2000)은 2메가 픽셀을 지원하는 카메라 컨트롤러 개념이다. 12월 양산을 위해 현재 마무리 작업을 진행하고 있다는 게 회사 관계자의 전언이었다.

이 칩에 이어 마무리안디자인은 내년 썸 멀티미디어 프로세서 출시할 예정이다.

네오와인(www.neowine.co.kr)은 복제방지 솔루션을 출시했다. 모바일기기의 불법 생산을 막아주는 칩이다. 네오와인이 개발한 칩이 메인CPU와 암호화기능을 해야만 휴대폰이 정상적인 작동을 하기 때문에 제3국에서 휴대폰을 양산하더라도 불법 생산을 막을 수 있다. **K**

